



各 位

平成 23 年 4 月 25 日

会 社 名 日 本 電 子 材 料 株 式 会 社
代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 坂 根 英 生
(コード番号 6855 東証 1 部)
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 部 門 統 括 部 長 足 立 安 孝
電 話 0 6 (6 4 8 2) 2 0 0 7

個別業績予想の修正に関するお知らせ

当社は、平成 22 年 10 月 5 日に公表した平成 23 年 3 月期（平成 22 年 4 月 1 日～平成 23 年 3 月 31 日）の業績予想を修正いたしましたのでお知らせいたします。

記

業績予想の修正について

平成 23 年 3 月期通期個別業績予想数値の修正(平成 22 年 4 月 1 日～平成 23 年 3 月 31 日)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益	1 株当たり 当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
前回発表予想 (A)	10,000	250	280	140	13.22
今回修正予想 (B)	9,247	114	322	199	18.85
増減額 (B - A)	753	136	42	59	
増減率 (%)	7.5	54.4	15.0	42.1	
(ご参考) 前期実績 (平成 22 年 3 月期)	7,901	901	859	603	56.97

修正理由

当社は、上期（4 月～9 月）の実績と、半導体市場の減速への懸念、円高や価格競争の激化の影響、M タイププローブカード「MC シリーズ」のより一段の性能向上のための費用発生等を踏まえて、平成 22 年 10 月 5 日付で連結業績予想、および個別業績予想を修正いたしました。

これに対して下期（10 月～3 月）につきましては、「MC シリーズ」の性能向上は完了致しましたが、実現に至るまでに時間を要した事が売上確保に影響を与え、個別業績の営業利益が予想を下回る見通しとなりました。これに対し海外子会社からの受取配当等により、経常利益および当期純利益は、予想を上回ることが出来ました。なお連結業績予想、および年間 1 株当たり 10 円（第 2 四半期 5 円、期末 5 円）の配当予定に変更はありません。

以上

上記の業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。